



广东惠伦晶体科技股份有限公司
2020 年向特定对象发行股票预案
(修订稿)

二〇二〇年九月

发行人声明

公司及全体董事会成员承诺：本次向特定对象发行股票预案的内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本预案按照《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等要求编制。

本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

本次向特定对象发行股票预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

重要提示

1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第三届董事会第十五次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。2020 年 9 月 4 日公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，主要对向特定对象发行股票方案中发行对象进行调整。根据有关法律、法规的规定，本次向特定对象发行股票方案及相关事项尚需通过深交所审核和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交

所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由董事会根据股东大会的授权,和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和文件的规定,根据投资者申购报价情况协商确定。

4、本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 60,000,000 股(含),不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间,若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定进行相应调整。

5、本次向特定对象发行股票的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次向特定对象发行股票结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

6、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目	45,232.40	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	55,232.40	50,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

7、本次向特定对象发行不构成重大资产重组,不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

8、本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

9、公司一直重视对投资者的持续回报,关于公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及未分配利润使用情况、股东回报规划等情况,详见本预案“第五节 公司利润分配政策及相关情况”。

10、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第六节 董事会声明及承诺事项”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益等假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证,公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,敬请投资者注意投资风险。

11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第四节 本次股票发行相关的风险说明”之“二、本次向特定对象发行相关风险”有关内容,注意投资风险。

12、本次向特定对象发行股票后,公司的每股收益短期内存在下降的风险,公司原股东即期回报存在被摊薄的风险,为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并对填补被摊薄即期回报采取了相应措施,且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺;但所采取的填补回报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证,特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第六节 董事会声明及承诺事项”之“二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施”。

目 录

发行人声明.....	2
重要提示.....	3
目 录.....	6
释 义.....	8
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	10
一、发行人基本情况.....	10
二、本次向特定对象发行的背景和目的.....	10
三、本次向特定对象发行方案.....	13
四、本次发行是否构成关联交易.....	16
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化.....	16
六、本次向特定对象发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件.....	16
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.....	17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	18
一、募集资金使用计划.....	18
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析.....	18
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响.....	23
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	25
一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况.....	25
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.....	26
三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....	26
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.....	26
五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	

.....	27
第四节 本次股票发行相关的风险说明	28
一、与发行人经营相关的风险.....	28
二、本次向特定对象发行相关风险.....	31
第五节 公司利润分配政策及相关情况	33
一、公司股利分配政策.....	33
二、公司最近三年利润分配情况.....	34
三、公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划	35
第六节 董事会声明及承诺事项	39
一、董事会关于除本次发行外未来 12 个月内是否有其他股权融资计划的声明.....	39
二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施.....	39

释 义

在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

一般性释义：		
发行人/公司/本公司/惠伦晶体/上市公司	指	广东惠伦晶体科技股份有限公司
本预案	指	广东惠伦晶体科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
本次向特定对象发行/本次发行	指	本次广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的行为
定价基准日	指	本次发行期首日
股东大会	指	广东惠伦晶体科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
新疆惠伦	指	新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
公司章程	指	广东惠伦晶体科技股份有限公司章程
KDS	指	大真空株式会社
NDK	指	日本电波工业株式会社
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
专业名词释义：		
5G	指	第五代移动通信技术
物联网	指	物联网（The Internet of Things，简称 IOT）是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
压电石英晶体元器件	指	利用石英晶体（即水晶）的逆压电效应（在外电场作用下产生弹性形变的特性）制成的机电能量耦合的频率控制元器件，因其较高的频率稳定性和高 Q 值（品质因数）以及主要原材料人造水晶价格较低等突出优点，成为频率控制、稳定频率和频率选择的重要元器件，主要包括谐振器、振荡器和滤波器三大类。
谐振器	指	石英晶体谐振器的简称，是通过在石英晶片两面镀上

		电极而构成的频率元件。交变信号加到电极上时谐振器会起振在特定的频率上，谐振频率和晶体的厚度有关系，通过加工，谐振器可以工作在任何的频率上。电子产品涉及频率控制与选择都需要谐振器。
振荡器、CXO	指	石英晶体振荡器的简称，是一种频率稳定器件，用来产生重复电子讯号（通常是正弦波或方波），能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。根据振荡器实现的性能，国际电工委员会(IEC)将石英晶体振荡器分为4类：即普通晶体振荡器(SPXO)、电压控制式晶体振荡器(VCXO)、温度补偿式晶体振荡器(TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO)。
TCXO	指	Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator 的缩写，译为“温度补偿晶体振荡器”。TCXO 是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。
VCXO	指	Voltage Controlled X'tal (crystal) Oscillator 的缩写，译为“电压控制式晶体振荡器”。VCXO 是通过外加控制的电压来对振荡器的频率作小范围的调谐。
OCXO	指	Oven Controlled Crystal Oscillator 的缩写，译为“恒温晶体振荡器”，是利用恒温槽使晶体振荡器或石英晶体振子的温度保持恒定，将由周围温度变化引起的振荡器输出频率变化量削减到最小的晶体振荡器。
SMD	指	Surface-Mount Device 的缩写，译为“表面贴装式封装”，属于最新一代压电石英晶体元器件生产封装技术。表面贴装式元件相较于传统插装元件，有组装密度高、电子产品体积小、重量轻、可靠性高、抗振能力强和高频特性好等优点。表面贴装化是电子元器件的发展趋势。
TSX	指	热敏晶振，即在普通贴片晶体谐振器的基础上增加了一颗热敏电阻，以及一颗变容二极管，利用了变容二极管的容变功能在结合热敏的传感功能相结合，就变成了带有温度传感功能的热敏石英晶体元器件。
IC	指	集成电路(Integrated Circuit)的简称，是压电石英器件的核心部件。

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称	广东惠伦晶体科技股份有限公司
英文名称	Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.,LTD.
成立日期	2002年06月25日
注册资本	235,583,880元
法定代表人	赵积清
注册地址	广东省东莞市黄江镇东环路68号
办公地址	广东省东莞市黄江镇东环路68号
股票简称	惠伦晶体
股票代码	300460
股票上市地	深圳证券交易所
董事会秘书	王军
联系电话	0769-38879888-2233
传真号码	0769-38879889
电子信箱	flzqsw@dgylec.com
经营范围	设计、生产和销售新型电子元器件(频率控制与选择元器件)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次向特定对象发行的背景和目的

(一) 本次向特定对象发行的背景

1、5G及以上技术平台建设加速，压电石英晶体元器件行业迎来新的发展机遇

2020年2月，工业和信息化部明确要加快5G商用步伐，提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。压电石英晶体元器件是5G及以上技术中核心的电子元器件之一，主要应用于5G及以上技术平台移动终端和基站建设上。

随着5G及以上新技术平台的应用对于压电石英晶体元器件的性能提出更高要求，压电石英晶体元器件产品朝着高基频、小型化的方向发展。在5G及以上技术带动下，压电石英晶体元器件数量和价值在电子产品设备各模块应用中不断提升，高基频、小型化石英晶体元器件需求规模不断扩大。

公司的主要产品为压电石英晶体元器件，其中以SMD石英晶体谐振器、振

荡器为主，公司生产的 SMD2520、SMD2016、SMD1612 成为国内较早量产的小型化压电石英晶体元器件产品，SMD1210 已完成研制并处于试产阶段。在 5G 及以上技术平台建设加速的背景下，公司迎来良好的发展机遇。

2、贸易摩擦加剧，中高端压电石英晶体元器件产品进口替代加速

目前全球压电石英晶体元器件厂家主要分布在日本、中国大陆和中国台湾地区。日本是压电石英晶体元器件传统制造强国，2013 年以后，日本厂商受到原材料和人力资源成本上升及新工艺、新技术的应用等因素影响，中低端产品市场份额出现较大幅度下滑，全球产能逐渐向中国大陆地区转移。大陆厂商凭借国产生产制造设备自动化能力的提升和成本优势迅速发展，市场份额逐渐增加。根据日本水晶工业协会公布的数据，2017 年大陆厂商石英晶体元器件销售额约占全球的 10.10%，较 2010 年的 4.0% 增长将近 6.1 个百分点。

贸易摩擦加剧的背景下，高基频、小型化压电石英晶体元器件的产能转移和进口替代加速进行。压电石英晶体元器件供给主要由日本公司主导，尤其在整体产能特别是中高端产品领域具备主导能力。2017-2018 年，日本 NDK、KDS 业务收入均呈现下滑趋势。2018 年下半年以来，中美及日韩贸易摩擦加剧，国内知名通讯、整机、家电厂商为了保障产业链安全，积极在国内电子元器件行业寻求国产替代。近年来，国内压电石英晶体元器件企业的新产品研发、新技术、新工艺的不断应用，促使高基频、小型化压电石英晶体元器件中高端产品进口替代加速。

公司始终秉持科技创新为本的理念，持续研发新产品新工艺，增强公司的创新驱动力。一方面，公司自设立以来一直致力于压电石英晶体元器件的生产和研发，储备一定的研发技术、生产工艺、人才队伍和行业经验；另一方面，公司不断拓宽产品在新业态、新行业中的应用，聘请海外具有先进研发经验和专业学识的高级人才增强核心技术研发能力，继续加强产品高基频、小型化、薄型化、高精度等方向的研究力度。公司在高、中端谐振器和振荡器市场迎来“国产替代”机遇。

3、公司以打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商为目标，具备良好的技术水平和客户资源储备

公司拥有先进的生产制造技术水平和新产品研究开发能力,已有多项产品通过知名企业平台认证。公司在压电石英晶体元器件生产环节方面掌握了一系列核心技术,包括高基频、小型化压电石英晶片生产技术,多层、多金属溅射镀膜技术,高精密点胶技术,离子刻蚀调频技术和高频连续脉冲焊接技术等,能够生产附加值较高的高基频、小型化 SMD 谐振器及温度补偿振荡器(TCXO、TSX、VCXO)等产品。公司目前已取得高通、联发科(MTK)、海思、展锐、络达(Airoha)、恒玄(BES)、瑞昱(Realtek)、翱捷科技(ASR)、移芯、芯翼等多个平台和方案商对于多项产品的认证。

本次向特定对象发行完成后,公司将进一步深化拓展公司主营业务,满足 5G 及以上技术平台对压电石英晶体元器件的需求,实现进口替代。

(二) 本次向特定对象发行的目的

1、抓住 5G 及以上技术平台带来的市场机遇,实现公司高端压电石英晶体元器件产业化,满足行业发展需求

我国 5G 及以上技术平台商用加速将带动智能手机换机潮,开启万物互联新浪潮。2019 年 11 月,三大运营商正式上线商用套餐,5G 及以上技术平台商用正式启动。中国联通网络技术研究院预测,到 2024 年,中国 5G 用户将突破 10 亿户;到 2025 年,中国 5G 用户渗透率将达 90% 以上。随着 5G 网络的成熟,从智能穿戴生态,到智能家居、智能汽车、智慧交通、智慧城市、工业物联网的万物互联的浪潮将正式开启。

5G 及以上技术平台产品形态和应用场景的拓展对高基频、小型化压电石英晶体元器件的需求将大幅增加。为满足行业需求,公司将加快落实战略布局,利用已有的技术优势,提升高端压电石英晶体元器件规模,开拓更多市场,尽快实现高端产品的进口替代,更好地服务客户。

2、实现新技术、新工艺,扩大市场规模,提升公司核心竞争力

本次募投项目为高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目。该项目对于公司把握当前 5G 及以上技术、物联网高速发展的行业机遇,加强公司产品在高基频、小型化、高精度方向战略布局,提升公司高端产品的核

心竞争力具有重要作用。上述项目的实施将显著扩大公司高基频、小型化新产品的生产规模,满足客户和市场的要求,从而增强公司在相关业务领域的竞争能力,为公司业绩增长提供保证。

3、补充公司营运资金,提升公司抵御风险能力

公司目前资产规模较小,通过债务融资获得的资金规模有限。随着下游应用行业对石英晶体元器件的需求增加,公司对于资金的需求也比较大。因此公司拟通过向特定对象发行股票进一步提升公司资本实力,有效满足公司经营规模迅速扩张所带来的资金需求,并提升公司的市场竞争力。此外,利用本次向特定对象发行股票募集资金可一定程度上降低公司的融资成本,提高公司的短期偿债能力。

因此,本次向特定对象发行的募集资金部分用于补充流动资金,公司资金实力将得到进一步增强,能有效缓解公司快速发展产生的资金压力,提升公司的偿债能力,有利于降低公司财务风险,提高公司整体抗风险能力。

三、本次向特定对象发行方案

(一) 发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

(三) 定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日,本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股

本等除权除息事项,本次发行价格将按以下方法作相应调整:假设调整前发行价格为 P_0 , 每股送股或转增股本数为 N , 每股增发新股或配股数为 K , 增发新股或配股价格为 A , 每股派息为 D , 调整后发行价格为 P_1 , 则:

$$\text{派息: } P_1 = P_0 - D$$

$$\text{送股或转增股本: } P_1 = P_0 / (1 + N)$$

$$\text{增发新股或配股: } P_1 = (P_0 + A \times K) / (1 + K)$$

$$\text{三项同时进行: } P_1 = (P_0 - D + A \times K) / (1 + K + N)$$

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,由董事会根据股东大会的授权,和保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和文件的规定,根据投资者申购报价情况协商确定。

(四) 发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名(含 35 名),为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件,根据询价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行股票的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

(五) 发行数量

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,同时本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 60,000,000 股(含),不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后,由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间,若公司发生送红股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公司股份变动,本次向特定对象发行股份数量的上限将根据中国证监会相关规定进行相应调整。

(六) 限售期

本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的,依其规定。

本次发行股票结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

(七) 上市地点

本次向特定对象发行的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

(八) 募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高基频、小型化压电石英晶体元件产业化生产基地建设项目	45,232.40	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	55,232.40	50,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（九）未分配利润安排

本次向特定对象发行 A 股股票发行完成后，公司的新老股东按持股比例共享本次向特定对象发行前的公司滚存未分配利润。

（十）决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为上述发行方案的议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

四、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情况，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告日，新疆惠伦直接持有公司 58,090,980 股股份，持股比例为 24.66%，是公司的控股股东。赵积清持有新疆惠伦 92% 份额，任新疆惠伦执行事务合伙人，是公司的实际控制人。

本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，为确保公司实际控制权的稳定性，发行过程中，发行人将结合市场环境和发行人股权结构，对本次发行的认购者作出认购上限限制。

因此，本次向特定对象发行股票不会导致本公司控制权发生变化。

六、本次向特定对象发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次向特定对象发行股票的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

(一) 本次向特定对象发行已履行的程序

1、2020年7月30日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次向特定对象发行相关事项。

2、2020年8月18日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行相关事项。

3、2020年9月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过根据2020年第二次临时股东大会的授权对本次发行方案进行调整的事项。

(二) 本次向特定对象发行尚需履行的程序

1、本次发行方案经深交所审核通过。

2、中国证监会同意注册。

在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金金额
1	高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目	45,232.40	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	55,232.40	50,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额,不足部分公司自筹解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

(一) 高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地建设项目

1、项目概况

本项目预计总投资 45,232.40 万元,使用募集资金投入 40,000.00 万元,用于高基频、小型化压电石英晶体元器件产业化生产基地的建设,实施单位拟为公司全资子公司惠伦晶体(重庆)科技有限公司,拟建设周期为 1 年。本项目主要生产高基频、小型化压电石英晶体元器件产品,以满足 5G 及以上技术和物联网对高基频、小型化压电石英晶体元器件产品的需求,实现高、中端压电石英晶体元器件产品的进口替代。

2、项目实施的可行性

(1) 项目实施符合国家支持的政策方向

电子元器件是新一代信息技术的重要支撑，是高端电子装备、电子信息系统以及武器装备控制系统的重要基础。2016年1月，工业和信息化部发布《产业技术创新能力发展规划（2016—2020年）》，将石英晶体振荡器列为电子信息制造业重点发展方向之一；2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出要推动电子器件变革性升级换代，提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。本项目积极开展高基频、小型化压电石英晶体元器件产品的研发和生产，符合国家所支持的政策方向。

(2) 高基频、小型化压电石英晶体元器件产品市场需求旺盛，5G及以上技术平台和物联网的发展带动下游需求

5G及以上技术被誉为“数字经济新引擎”，是人工智能、自动化、物联网、云计算、区块链、视频社交等新技术新产业的基础。世界各国和各类国际组织高度重视5G及以上技术发展，纷纷把5G及以上技术列为优先发展的战略领域，积极支持5G及以上技术发展。2019年6月，我国工信部向运营商发放5G商用牌照，标志着我国正式进入5G商用元年。压电石英晶体元器件是5G及以上技术中核心的电子零部件之一，5G及以上技术对石英晶体元器件在高基频、小型化等方面提出了更高的要求。以频率和规格为例，华为、中兴通讯已将基站用压控石英晶体振荡器从3G/4G所需的122.88MHz升级到5G所需的245.76MHz；通讯产品从2G、3G到4G所需求的石英频率组件由3225规格24MHz升为48MHz，而5G通讯产品的需求频点及规格将进一步提升至1612规格52MHz、76.8MHz、96MHz等。这意味着，随着5G建设的加速，高基频、小型化压电石英晶体元器件的需求将会急剧增长。

与此同时，在5G及以上技术的支撑下，物联网将成为继计算机、互联网之后世界信息产业的第三次浪潮。在实现物联网的关键技术RFID射频识别技术中，高基频、小型化的压电石英晶体元器件如SMD1612、SMD1210等构成其核心零部件之一。据《2018—2019中国物联网发展年度报告》的数据显示，2018年我国物联网产业规模已超1.2万亿元，物联网业务收入较上年增长72.9%。江苏、浙江、广东等省产业规模均超千亿元，福建、重庆、上海、北京、江西等省市规

划十三五期末达到千亿元规模。根据工信部数据,预计 2020 年物联网规模突破 1.5 万亿元。高基频、小型化压电石英晶体元器件作为实现物联网的核心部件之一,也因为物联网的发展催生巨大的市场需求。

(3) 项目具备成熟的技术条件,公司掌握了实现高基频、小型化的关键技术——基于半导体技术的光刻工艺

压电石英晶体元器件朝着高基频和小型化的方向发展,公司近年来加大了研发投入,2017 年至 2020 年 1-6 月研发投入分别为 1,942.44 万元、2,284.31 万元、2,299.96 万元和 729.89 万元,占营业收入的比例分别为 5.35%、7.16%、7.42% 和 5.06%,公司目前已拥有了生产高基频、小型化产品的光刻工艺技术。

高基频方面,公司掌握了光刻工艺生产技术,具备生产高基频产品的能力。当前行业内普遍使用的机械研磨工艺由于研磨晶片厚度的局限性,即晶片 AT 切型厚度 $28\mu\text{m}$ (趋近 60MHz) 已近机械研磨加工工艺极限,难以批量生产高基频压电石英晶体元器件所需的石英晶片(5G 通讯技术通常要求 AT 切型厚度为 $20\sim 16\mu\text{m}$ 甚至更薄,频率要求为 80MHz~96MHz)。而基于半导体工艺的光刻工艺技术可以突破机械研磨工艺的限制,并成为高基频、小型化压电石英晶体产品批量生产的关键技术。公司紧跟当前国际行业前沿技术,目前已经具备光刻生产设备及技术,为 5G 及以上技术平台、物联网所要求的高基频产品的产业化奠定坚实基础。

小型化方面,压电石英晶体元器件产品规格尺寸随着下游应用领域的需求经历了 8045→7050→6035→5032→3225→2520→2016→1612→1210 等变化过程,目前小型化产品以 2520、2016、1612 和 1210 为主导。公司是国内较早量产 SMD2520、SMD2016、SMD1612 小型化压电石英晶体元器件产品的厂商之一,且 SMD1210 已完成研制并处于试产阶段。本次募投项目产品主要集中在 2520→2016→1612→1210 区段,符合未来产业发展趋势,可以有效满足未来 5G 及以上技术、智能穿戴设备行业的需求。

(4) 公司拥有充足的人才储备,为项目实施提供人才保障

公司拥有一支行业经验丰富的管理人才和技术人才团队。截止 2019 年末,

公司拥有研发人员 121 人。一方面，公司注重内部优秀人才的培养，鼓励员工创新；另一方面，公司大力引进外部高端人才，丰富人才储备。通过建立高效的激励机制和竞争机制，公司已具备项目实施所需的人才储备。

3、项目实施的必要性

(1) 实现技术突破，打破国外垄断，实现进口替代的需要

目前，我国已经成为世界电子基础材料和元器件的生产大国，部分产品产量居世界前列。未来几年，随着下一代互联网、新一代移动通信、数字化产品的逐步推进，电子整机产品的更新换代，对电子材料和元器件产业的发展提出了更高的要求。新技术、新产品的开发和产业化所需的技术和资金门槛越来越高，投资风险增大，产品更新换代速度进一步加快，电子信息产业链垂直整合和企业横向整合趋势将更加明显，产业集中度不断提高，国内企业面临严峻挑战。

从技术发展趋势看，在下游电子产业发展的推动下，压电石英晶体元器件产品开发方向主要呈现以下发展态势：①高基频、小型化；②高精度、模块化；③低功耗；④绿色环保要求逐步提高，其中，高基频和小型化是最为重要的发展趋势。

公司自主研发的压电石英晶体 SMD1612、SMD1210 等高基频、小型化产品，正符合行业对技术发展的要求，产品规格将成为下一代主流成品的行业标准。高基频、小型化产品的量产，既打破国内压电石英晶体元器件高端产品由境外厂商（主要是日本和台湾地区厂商）垄断的格局，实现国内高端产品的进口替代，同时也推动行业技术水平的发展。

(2) 抢占高基频、小型化先机，扩大国内市场占有率的需要

随着 5G 及以上技术和物联网的加速发展，下游电子产业对高基频、小型化产品的需求与日俱增。三大运营商合计 2020 年计划在 5G 网络投资约 1,803 亿元，同比大幅增长 338%，5G 将进入规模建设期。据估计 2020 年我国物联网规模将突破 1.5 万亿元，物联网时代将带动一系列相关产业的高速发展。由此可见，高基频、小型化压电石英晶体元器件的市场前景非常广阔。而 SMD1612 的量产和 SMD1210 的试产，使得公司的技术水平与国际先进技术同步，使公司产品与国

际领先系列产品接轨,同时,也为公司在即将到来的由技术更新而引发的替代进口中抢占技术制高点及市场先机。

(3) 拓展公司新盈利增长点的需要

目前公司是国内压电石英晶体元器件的龙头企业之一,公司在技术及规模上处于国内行业前列,较早实现了 SMD1612 等小型化产品的量产和 SMD1210 的试产。为了充分发挥自身主业的核心技术优势,公司需要进一步引进国际先进的高精度自动化生产设备,推动高基频、小型化产品规模产业化,促进公司在业务拓展中提升产品竞争力,实现新的利润增长点。

4、项目经济评价

项目达产年可实现年营业收入 43,499.67 万元,税后内部收益率为 14.28%,税后投资回收期 7.80 年(含建设期),具有良好的经济效益。

5、项目涉及报批事项情况

截至本预案公告日,本项目已取得重庆市万盛经济技术开发区发展改革局出具的《重庆市企业投资项目备案证》(备案项目编码:2020-500110-39-03-132546),已取得重庆市万盛经济技术开发区生态环境局出具的《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(万盛经开)环准[2020]045 号)。本次募投项目建设地点位于重庆市万盛经开区鱼田堡高新技术产业园,用地面积 55,926 平方米,已经取得相应的不动产权证书(证号:渝(2020)万盛区不动产权第 000773039)。

(二) 补充流动资金

1、项目概况

公司拟将本次募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金,满足公司日常生产经营资金需求,进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。

2、项目实施的必要性

(1) 公司的业务拓展需要保持较高的资金投入水平

公司主要产品为压电石英晶体元器件,随着 5G 时代的到来,预计国内市场

对压电石英晶体元器件的需求将会出现爆发式增长。但是下游应用市场的需求具有多样性和变化性，多样性体现在通讯电子、汽车电子、消费电子、物联网、智能穿戴、工业控制、家用电器、航天与军用和安防智能化等应用市场对压电石英晶体元器件都有广泛需求。变化性体现在各个行业对产品性能的要求各有侧重。

针对行业需求结构分散的特点，以及国内外销售环境的变化，公司需在研发和销售上保持较高的投入。研发层面，公司必须保持前瞻性研发投入，紧跟行业最新发展技术，以保持技术先进性。销售层面，公司需要加大国内销售网络和销售团队的建设，以应对贸易战和疫情等不利外部环境对境外销售的影响。

本次募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金，为公司运营资本提供稳定的资金来源，将有效支持公司研发投入和销售网络建设，增强公司的可持续盈利能力。

(2) 公司需要加大长期股权资本投入，保持较高的抗风险能力。

由于受宏观环境、行业特点和自身业绩波动的影响，公司通过银行渠道获得的融资规模较小，一定程度上制约了公司的发展。一是 2018 年和 2019 年宏观经济景气度下行，银行收紧银根，公司获得银行融资的难度加大；二是公司处于石英晶体元器件行业，行业特点决定了公司的设备主要为专用设备，无法通过设备抵押获得银行信贷；三是公司 2018 年和 2019 年受商誉减值的影响，经营业绩出现下滑，而未来盈利的释放需要时间，导致银行对公司的支持力度较小。截至 2020 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 5,043.51 万元，无长期借款余额，借款余额占已获批银行流动资金贷款授信额度的 56.04%。

本次募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金，公司可以有效规避外部融资环境的不利变化对公司的影响，提升公司的抗风险能力。

总之，本次公司拟以 10,000.00 万元募集资金补充流动资金符合相关政策和法律法规规定，符合公司目前的实际情况和业务发展需求，有助于缓解公司在主营业务经营的资金压力，增强公司的抗风险能力，有利于公司的经营业绩提升和业务的长远发展。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金运用符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向。募集资金到位后，将进一步增强公司的研发实力，提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，巩固公司及全体股东的利益，为公司做大做强提供有力的资金保障。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司的财务状况将得到进一步改善，公司总资产及净资产规模将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，本次发行可能导致公司净资产收益率下降，每股收益摊薄。

本次发行完成后，上市公司将获得大额募集资金的现金流入，筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募投项目的逐步建成和投产，公司主营业务收入规模将大幅增加，盈利水平将得以提高，经营活动产生的现金流入将得以增加，从而相应改善公司的现金流状况。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况

(一) 本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划

公司暂无在本次发行后对公司业务及资产的整合计划。

(二) 对公司章程的影响

本次发行将导致公司的股本总额相应增加，因此，公司将在本次发行完成后，根据股东大会的授权针对上述变化情况对公司章程的相应部分进行修改，并办理工商变更。

(三) 对股东结构的影响

截至本预案公告日，新疆惠伦直接持有公司 58,090,980 股股份，持股比例为 24.66%，是公司的控股股东；赵积清持有新疆惠伦 92% 份额，任新疆惠伦执行事务合伙人，是公司的实际控制人。

本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，为确保公司实际控制权的稳定性，发行过程中，发行人将结合市场环境和发行人股权结构，对本次发行的认购者作出认购上限限制。

因此，本次向特定对象发行股票不会导致本公司控制权发生变化。此外，本公司股权分布仍符合上市条件，本次发行亦不会导致本公司股权分布不具备上市条件的情形。

(四) 对高管人员结构的影响

公司不会因本次发行而调整公司的高管人员，公司的高管人员结构在本次发行完成后短期内不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，

履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）对业务结构的影响

本次募投项目达产后，预计高基频、小型化产品产能将得到提升，收入占比将持续增加，盈利能力将有所增强。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将大幅增加，公司的资产负债率将会有所下降，公司财务状况得到改善，有利于降低公司财务风险。

（二）对盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后，公司净资产和总股本将有所增加，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着公司业务规模的不断扩大，募集资金投资项目效益的实现，公司的盈利能力将会进一步增强。

（三）对现金流量的影响

本次向特定对象发行完成后，由于发行对象以现金认购，公司的筹资活动现金流入将大幅增加。待募集资金产生效益之后，公司的经营活动现金流入将相应增加。

三、发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均未发生变化，也不会导致公司与控股股东及其关联人产生同业竞争和新的关联交易。

四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控

股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

公司的资金使用和对外担保严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定履行相应授权审批程序并及时履行信息披露义务，不存在被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用资金、资产或违规为其提供担保的情形。本次发行完成后，公司不会因本次发行产生被控股股东、实际控制人及其关联人违规占用公司资金、资产或为其提供担保的情形。

五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 39.78%（合并报表口径）。本次发行完成后，公司资产负债率将有所下降，财务结构将更加稳健，抗风险能力将进一步加强。公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况，也不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

第四节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次向特定对象发行股票方案时,除本预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:

一、与发行人经营相关的风险

(一) 产品价格波动的风险

2017年至2019年公司产品平均售价呈现下降趋势。公司的主要产品压电石英晶体谐振器是电子信息化产业产品中的频率控制与选择核心元件,在国民经济各个领域如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域均有广泛应用。随着技术水平及生产效率的提高,下游行业产品的价格有下降趋势,导致了电子元器件产品的价格下降,对公司的盈利能力有一定的不利影响。

虽然2020年上半年,石英晶体产品价格有所回升,但是如果未来市场竞争加剧,公司产品价格存在再次下降的风险。若公司不能有效的降低成本,抵销产品平均价格下降的影响,可能导致毛利率出现下滑,从而影响公司的经营业绩。

(二) 原材料价格波动的风险

公司生产产品需要的主要原材料为晶圆、基座和上盖,主要向京瓷株式会社、住友化学株式会社、日本爱斯国际贸易株式会社、潮州三环(集团)股份有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司等采购,如果原材料价格发生较大波动,公司不能将成本压力合理转移,将对公司毛利率造成一定不利影响,因此公司面临一定的原材料价格变动风险。

(三) 市场竞争加剧的风险

目前,公司依靠已经掌握的先进技术水平,能够生产附加值较高的小型化SMD谐振器及TCXO、TSX等振荡器产品。如果公司的技术研发方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差,或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化,将使公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被替代的风险。同时,

石英晶体谐振器的研发前期投入较大,如果销售数量不能达到预期,将面临前期投入无法收回的风险,给公司造成投资损失并影响公司盈利水平。

(四) 营业收入及净利润波动的风险

公司营业收入和净利润波动变化十分明显。2017年至2020年1-6月,公司营业收入分别为36,327.82万元、31,898.70万元、30,994.27万元和14,435.39万元,归属于上市公司股东的净利润分别为2,335.69万元、-2,229.44万元、-13,295.20万元和427.34万元。

2018年、2019年公司连续两年亏损,主要受资产减值、加大营销网络建设、加强5G研发投入等因素影响。2020年上半年,公司扭亏为盈,主要因为公司销售战略转型取得一定成效,直销客户订单和自有品牌产品订单持续增加,主营产品毛利率增加。

如果未来公司不能将研发、销售等投入有效转化为提升收入规模、增强盈利能力,将面临收入下降、盈利下滑的风险。

(五) 应收账款金额较高的风险

公司应收账款净额较高。2017年至2020年6月30日,公司应收账款净额分别为14,440.45万元、13,086.82万元、19,472.07万元和19,349.55万元,占当期末资产总额的比例分别为12.96%、13.19%、24.16%和22.12%。受公司销售模式、结算方式、信用账期、业务规模等多种因素影响,报告期内公司应收账款呈上升趋势。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量,给公司的营运资金带来一定的压力。如果公司应收账款总额持续增加,存在应收账款不能按期回收或无法回收的风险,进而对公司业绩和生产经营产生不利影响。

(六) 新增固定资产折旧影响未来经营业绩的风险

本次募集资金投资项目建成后,公司的固定资产较本次发行前将有较大规模的增加,由此带来每年固定资产折旧的增长。本次募集资金投资项目建成后,存在产能爬坡,市场逐步开拓的周期,虽然公司扣除上述折旧费用的预计净利润增长幅度将远超过折旧费用的增长幅度,但募投项目建成后折旧费用的增加仍可能

在短期内影响公司收益的增长。

(七) 汇率风险

公司受汇率的影响主要体现在原材料及生产设备的采购及产品销售两个方面。一方面,公司的原材料及生产设备主要从国外进口,进口原材料和设备主要以日元和美元结算,如果人民币兑美元或兑日元贬值,公司以美元或日元进口原材料及设备的成本将上升。另一方面,公司的产品出口比重较高,且以日元和美元为主要结算货币。2017年至2020年1-6月,公司境外销售收入分别占主营业务收入的73.34%、67.85%、49.49%和45.53%,若人民币兑美元持续升值,将对产品出口造成不利影响。

(八) 中美贸易摩擦加剧的风险

2018年以来,中美贸易摩擦不断加剧,美国政府已将华为等中国先进制造业的代表企业列入美国出口管制的“实体清单”中。若美国不断加强“实体清单”的限制,可能短期内会给包括华为在内的国内通讯厂商、整机厂商造成一定的负面影响,通过产业链传导,可能会给公司的生产经营和盈利能力带来潜在的不利影响。同时,中美贸易摩擦不断加剧可能会影响公司的出口业务,进而可能造成销售收入的下滑。

(九) 核心技术泄密风险

公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识产权是公司核心竞争力的体现。一旦公司的核心技术泄露,将会对公司的发展产生较大的影响。随着公司规模扩大,人员及技术管理的复杂程度也将提高,虽然公司已和核心技术人员签订了《保密协议》和《竞业禁止协议》,约定保密和竞业禁止相关事项,但是如果约束及保密机制不能伴随着公司的发展而及时更新,一旦发生核心技术的泄露的情况,公司的技术优势将被削弱,业务发展将受到影响。

(十) 人才流失的风险

公司属于技术密集型企业,优秀的员工素质与公司的发展紧密相关。经过多年的培养与持续发展,公司已拥有一支稳定、高素质的技术人才队伍,不断地推

动公司发展。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失,生产经营将受到一定的影响。尽管公司制定了有效的激励机制,但是随着企业间和地区间人才竞争的日趋激烈,若核心技术人员流失,将给公司生产经营和新产品研发带来负面影响。

(十一) 商誉减值风险

公司 2017 年收购广州创想云科技有限公司,形成了一定金额的商誉,截止 2020 年 6 月 30 日,公司账面商誉金额为 2,262.50 万元,占公司合并报表口径总资产的比例为 2.59%。2018 年度,公司已根据被收购企业的实际经营情况并在保持谨慎性的原则下对 10,423.06 万元商誉计提减值准备;2019 年度,公司继续计提商誉减值准备 7,723.77 万元;未来公司将继续于每年年末对商誉进行减值测试。被收购企业的经营业绩受多方面因素的影响,具有一定不确定性,可能导致该部分商誉存在一定减值风险。商誉减值将直接影响公司利润,对公司的经营业绩造成不利影响。

(十二) 新型冠状病毒疫情风险

2020 年一季度受新型冠状病毒疫情风险影响,全国的各项生产经营活动均受到不同程度的影响。目前国内疫情已得到较好控制,且公司采取多项有效的疫情防控措施,全力保障公司正常的生产和运营,但若境外输入病例增多或后续防控措施不到位,以及海外新型冠状病毒的疫情未能在短期内得到控制,终端产品出口可能受阻,将传导至处于上游的石英晶体元器件产业,进而可能对公司经营效益造成不利影响。

二、本次向特定对象发行相关风险

(一) 审核风险

公司本次发行的有关事项经公司董事会和股东大会审议通过后,尚需经深圳证券交易所审核通过和证监会同意注册。前述批准或核准均为本次向特定对象发行的前提条件,而能否获得该等批准或核准存在不确定性,提请投资者注意本次发行存在无法获得批准的风险。

(二) 本次发行摊薄即期回报的风险

本次向特定对象发行将增加公司的股本总额及净资产规模,若公司净利润的增长速度在短期内低于股本及净资产的增长速度,则存在发行后每股收益和净资产收益率短期被摊薄的风险。

(三) 股票价格波动风险

本公司的 A 股股票在深交所创业板上市,除经营和财务状况之外,本公司的 A 股股票价格还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

第五节 公司利润分配政策及相关情况

一、公司股利分配政策

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等文件要求，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，公司制定了合适的利润分配政策。本次向特定对象发行股票完成后，惠伦晶体将继续遵循《公司章程》中制定的利润分配政策积极对公司股东给予回报，本次向特定对象发行股票后公司的利润分配政策不存在重大变化。公司关于利润分配政策的主要内容如下：

（一）利润分配原则

公司可采用现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般进行年度分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

（二）现金分红比例

公司应当优先采用现金分红方式进行利润分配。公司发放股票股利时，应当同时做出现金分红的安排。

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；

（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或

重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

(三) 利润分配方案

在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订利润分配方案，利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。董事会可根据公司具体情况提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

二、公司最近三年利润分配情况

(一) 最近三年利润分配

1、2018 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》，具体情况如下：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 168,274,200 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 5,048,226.00 元（含税）；不送股、也不以资本公积转增股本。上述利润分配方案经公司 2017 年年度股东大会审议通过。上述利润分配方案已实施完毕。

2、2019 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》，具体情况如下：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

3、2020 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，具体情况如下：2019 年度不

派发现金红利，以 16,827.42 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 6,730.97 万股，转增后总股本增至 23,558.39 万股。上述利润分配方案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。上述利润分配方案已实施完毕。

（二）最近三年现金分红

公司最近三年现金分红具体情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2017 年度	5,048,226.00	23,356,931.14	21.61%
2018 年度	-	-22,294,391.32	-
2019 年度	-	-132,952,022.58	-

2017 年度，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，符合公司章程以及利润分配规划的规定。

由于 2018 年和 2019 年公司亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2018 年度和 2019 年度不进行现金分红，符合公司章程以及利润分配规划的规定。。

（三）未分配利润的使用安排

最近三年公司实现的归属于上市公司股东的净利润在向股东分配后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。公司注重经营利润在经营发展与回报股东之间的合理平衡，未来公司未分配利润仍将继续用于生产经营用途。

三、公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划

公司于 2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》，并经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的主要内容如下：

（一）制定本规划考虑的因素

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（二）制定本规划的原则

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合分析公司所处行业特征、经营发展情况、未来发展计划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（三）未来三年（2020年-2022年）具体股东回报规划

1、利润分配的原则、形式

公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

2、现金分红的条件

公司实施现金分红应满足以下条件：

（1）公司当年合并报表实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

(3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元;

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

3、现金分红的比例和时间

在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、股利分配条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在提出现金股利分配预案的同时,提出并实施股票股利分配预案。

5、利润分配的间隔

在在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。

(四) 利润分配的决策程序和机制

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

2、董事会制定调整股东回报规划的议案时,应经过详细论证、充分考虑中小股东的意见,并详细说明调整理由,经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议。独立董事应对股东回报规划的调整或变更事项发表明确独立意见,监事会发表审核意见。

3、股东大会审议制定或修改股东回报规划相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。

第六节 董事会声明及承诺事项

一、董事会关于除本次发行外未来 12 个月内是否有其他股权融资计划的声明

除本次发行外,根据已经规划及实施的投资项目进度,综合考虑公司资本结构、融资需求等因素,公司未来 12 个月内不排除安排其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资,将按照相关法律法规履行审议程序和信息披露义务。

二、公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行并做出了承诺,具体内容如下:

(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算

1、测算的假设前提

(1) 国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化;

(2) 假定本次发行方案 2020 年 11 月 30 日实施完毕,本次方案发行不超过 6,000.00 万股(最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定),募集资金总量为 50,000.00 万元,不考虑扣除发行费用等因素的影响;

(3) 本次向特定对象发行的股份数量、募集资金总额和发行完成时间仅为假设,最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行

完成时间为准；

(4) 在预测公司本次发行后总股本时，以本次发行前总股本 23,558.39 万股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响；

(5) 不考虑本次发行募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等方面的影响；

(6) 公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-13,295.20 万元。假设 2020 年度归属于上市公司股东的净利润与 2019 年度净利润持平或与 2017 年度净利润持平。

(7) 在预测公司净资产时，未考虑募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司 2020 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算

(1) 情形 1：假设 2020 年度归属于上市公司普通股股东的净利润与 2019 年度的净利润持平

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年度/2020 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
期初归属于上市公司股东的净资产	65,633.92	52,338.72	52,338.72
本期归属于上市公司股东的净利润	-13,295.20	-13,295.20	-13,295.20
当次发行募集资金	-	-	50,000.00
发行完成月份	-	-	2020 年 11 月
期末归属于上市公司股东的净资产	52,338.72	39,043.52	89,043.52
期初总股本（万股）	16,827.42	23,558.39	23,558.39
本次发行数量上限（万股）	-	-	6,000.00
期末总股本（股）	16,827.42	23,558.39	29,558.39
基本每股收益（元/股）	-0.7901	-0.5644	-0.5414
稀释每股收益（元/股）	-0.7901	-0.5644	-0.5414
加权平均净资产收益率（%）	-22.54%	-29.10%	-24.61%

注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—

净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

(2) 情形 2: 假设 2020 年度归属于上市公司普通股股东的净利润与 2017 年度的净利润持平

项目	2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期初归属于上市公司股东的净资产	65,633.92	52,338.72	52,338.72
本期归属于上市公司股东的净利润	-13,295.20	2,335.69	2,335.69
当次发行募集资金	-	-	50,000.00
发行完成月份	-	-	2020年11月
期末归属于上市公司股东的净资产	52,338.72	54,674.41	104,674.41
期初总股本(万股)	16,827.42	23,558.39	23,558.39
本次发行数量上限(万股)	-	-	6,000.00
期末总股本(股)	16,827.42	23,558.39	29,558.39
基本每股收益(元/股)	-0.7901	0.0991	0.0951
稀释每股收益(元/股)	-0.7901	0.0991	0.0951
加权平均净资产收益率(%)	-22.54%	4.37%	3.78%

注:基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

根据上述测算,在完成本次向特定对象发行后,公司总股本将会相应增加,公司即期基本每股收益和稀释每股收益会出现一定程度的摊薄。本次融资募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

(二) 本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示

本次发行摊薄即期回报的风险提示参见本预案“第六节 本次股票发行相关的风险说明”之“二 本次向特定对象发行相关风险”中的“(二) 本次发行摊薄即期回报的风险”。

(三) 董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家相关产业政策,以及公司所处行业发展趋势和未来发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及公司全体股东的利益。本次发行募集资金的必要性和合理性参见本预案“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”。

(四) 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,公司拟通过加强募集资金管理,提高募集资金使用效率,巩固和提升主营业务,加快募投项目实施,提高公司盈利能力,强化投资者回报机制等措施,提升资产质量,实现可持续发展,以填补股东回报。具体措施如下:

1、加强募集资金管理,保证募集资金安全和募投项目的顺利实施

公司按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求,建立了完善的《募集资金管理制度》,从制度上保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险,保证募集资金投资项目的顺利实施,提升募集资金使用效率,争取早日实现预期收益。公司将根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议,把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理制度》将募集资金用于承诺的使用用途。公司本次向特定对象发行股份的募集资金到位后,可在一定程度上满足公司业务发展的资金需求,优化公司财务结构,综合提升公司资本实力及盈利能力。

2、加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力

公司过去几年的经营积累和技术储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,节省公司的各项费用支出,全面有效地控制公司经营和管控风险。

3、加强募投项目推进力度,尽快实现项目预期收益

本次发行募集资金投资项目的实施,有利于扩大公司的市场影响力,进一步提升公司竞争优势,提升可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目尽快完成,实现对提高公司经营业绩和盈利能力贡献,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

4、完善利润分配政策,强化投资者回报机制

公司现行《公司章程》已经建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后,

公司将按照法律、法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）的规定，公司董事会制定了相应的《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，以细化《公司章程》相关利润分配的条款，确保股东对于公司利润分配政策的实施进行监督。

综上，本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，促进募投项目顺利产生经济效益，持续采取多种措施改善经营业绩，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，以保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高公司未来的回报能力。

（五）公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

（1）承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；

（2）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会和深圳证券交易所做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

（3）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本企业/本人对此做出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业/本人违法该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

2、董事、高级管理人员承诺

公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

(1) 不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 对自身的职务消费行为进行约束；

(3) 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

(7) 本人将切实履行前述有关填补即期回报措施及相关承诺，若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担公司或者投资者的赔偿责任。

(六) 履行的程序

2020年7月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关主体承诺事项的履行情况。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2020年9月4日